



Таблица 1 - Данные отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметры отверстий, мм	Диаметры контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
	$0,3^{+0}_{-0,13}$	$0,6^{+0}_{-0,13}$	Есть	56
	$1,0^{+0,1}_{-0,1}$	$1,5^{+0,1}_{-0,1}$	Есть	27
	$3,0^{+0,2}_{-0,2}$	Нет	Нет	4

- 1.\* Размеры для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12,  $\pm IT_{\frac{12}{2}}$
3. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-2002 – Н
4. Шаг координатной сетки 1,25 мм
5. Плату изготовить комбинированным позитивным методом
6. Класс точности платы по ГОСТ Р 53429-2009 –З:
  - минимальная номинальная ширина проводника – 0,25 мм;
  - минимальное номинальное расстояние между элементами проводящего рисунка – 0,25 мм;
  - минимальный номинальный диаметр переходного отверстия – 0,3 мм.
7. Параметры отверстий, контактных площадок платы приведены в таблице 1
8. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости – 3
9. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86, контактных зон – припой ПОС -61 ГОСТ 21930-76 толщиной не менее 35 мкм.
7. Остальные технические требования по ОСТ 4 ГО.070.014-75

ИУ 4.11.03.03.22.08.83.11.002						Устройство учета электронных компонентов			Лист	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		Плата печатная					2:1
Разраб.		Кутаев К. С.							Лист	Листов	1
Провер.		Гладких А. А.							МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Т. контр.									Кафедра ИУ 4		
Н. контр.									Группа ИУ 4-83 Б		
Утв.									Формат А2		